

スマートプロセス学会誌

目次 Vol. 11 No. 6 2022 (令和4年11月)

ナノ構造が切り拓く最先端エレクトロニクス

会告	N25
巻頭言	ナノ構造が切り拓く最先端エレクトロニクス 小山真司.....	271
解説	有機酸被覆銅微粒子を利用した低温焼成技術 米澤 徹・塚本宏樹.....	272
	還元機能を有する溶剤を用いた銅ペーストの焼結性能および接合性能 小畑貴慎・池田万里・板谷 亮・菅沼克昭.....	278
	機能性ナノ多孔質セラミックス薄膜の成膜技術 菅原 徹.....	284
	ナノシートエレクトロニクスを基盤とする生体貼付型デバイスの開発 藤枝俊宣.....	289
研究論文	Ag-Cu 複合焼結層の耐熱性評価 松田朋己・山田晴悟・廣瀬明夫.....	294
会報・掲示板	N28

Journal of Smart Processing
Vol. 11 No. 6 2022 (November 2022)

CONTENTS

Nanostructures Open the Way to Cutting-Edge Electronics

S.P.S. AnnouncementN25

Preface

Nanostructures Open the Way to Cutting-Edge Electronics

Shinji KOYAMA271

Reviews

Low Temperature Sintering Process Using Organic Acid Stabilized Copper Fine Particles

Tetsu YONEZAWA and Hiroki TSUKAMOTO272

Sinterability and Bondability of Cu Paste Using Reductive Solvent

Takanori KOBATAKE, Banri IKEDA, Ryo ITAYA and Katsuaki SUGANUMA278

Film Formation Technology for Functional Nano-Structured Ceramic Thin Films

Tohru SUGAHARA284

Development of Bio-Interfaced Device Based on Nanosheet Electronics

Toshinori FUJIE289

Research Papers

Evaluation of Heat Resistance of Ag-Cu Hybrid Sintering to Cu Substrate

Tomoki MATSUDA, Seigo YAMADA and Akio HIROSE294

S.P.S. NewsN28